

平成29年度 京都実装技術研究会オープニングセミナーの開催について

平成29年4月26日

京都府中小企業技術センター

担当：応用技術課 東技師

TEL：075-315-8634

京都府中小企業技術センターでは、電子機器の生産に深く関わる基盤技術として接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした「京都実装技術研究会」を毎年開催しています。

このたび、広く会員を募集するためにオープニングセミナー（無料）を下記のとおり開催します。

今回は、改正等の動向が注目され、対応が必要と考えられる環境規制、品質の確保に重要となる高信頼性接合材、および不具合の状況とその原因究明に必要な観察手法などについての講演会です。

記

1 日 時 平成29年5月23日（火） 午後1時30分 ～ 午後5時15分

2 場 所 京都府産業支援センター（京都府中小企業技術センター）研修室 5階

3 内容及び講師

(1) 「実装に関わる環境規制(RoHS,REACH等)の動向」

NPO法人 日本環境技術推進機構 横浜支部 理事

日本実装技術振興協会高密度実装技術部会幹事

NPOサーキットネットワーク(C-NET)理事 青木 正光 氏

講師は、東芝ケミカルヨーロッパ社社長、Nokia Japanグローバルソーシング本部ソーシング部長などを歴任され、現在、実装関連の学会等でご活躍されています。

今回は、改正等が行われた実装に関わる環境規制(RoHS/REACH等)の最新動向とグリーンエレクトロニクスの進展状況について、ご講演いただきます。

(2) 「高信頼性接合材（高耐熱はんだ、ナノAg焼結材等）について」

株式会社日本スペリア社 R&Dセンター 熊谷 圭祐 氏

SiCパワーデバイス等の高耐熱性・高信頼性ダイボンディングとしてのナノ銀焼結材料は、注目を浴びており、今回、実績のある『アルコナノ銀ペースト』をご紹介します。また、ISOで規格化され、世界的に認知され、普及している鉛フリーはんだである銀レスのSn-Cu-Ni系はんだ『SN100C』についてご紹介します。

(3) 「電子部品の破壊モードとその不具合解析における観察手法」

株式会社アイテス 山下 勝 氏

あらゆる製品や部品、素材について、故障・不良解析や信頼性試験等を実施されている株式会社アイテス様より、今回は、電子部品の開発段階における信頼性試験と故障解析の実際から、製品等の製造工程及び市場における故障・不良解析まで、実装に関わる不具合モードと原因究明に必要な解析時の観察技術について、アイテス様で実施されている手法や事例を紹介いただきながら、ご講演いただきます。

4 定 員 70名（先着順・定員になり次第、締切とします。）

5 申込締切日 平成29年5月19日（金）まで

6 申込先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気・電子担当

TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497

E-mail jisso@kptc.jp